

**Name:** Ludewig  
**Vorname:** Jörg



- Ausbildung:**
- Studium an der TH/TU Dresden, Schwachstromtechnik, Institut für Elektrischen u. Mechanischen Feingerätebau  
Abschluss Dipl. Ing.
- Berufserfahrung:**
- 1966 – 1976 Arbeitsstelle f. Molekularelektronik Dresden (AMD)
    - Wiss. Mitarbeiter Konstruktion, Technologieentwicklung
    - Gruppenleiter Bondtechnik
    - Abt.-Leiter Bondtechnik
  - 1976 – 1980 Institut für Mikroelektronik Dresden (IMD)  
Abt.-Leiter Montagetechnologie
  - 1980 – 1990 ZFTM /ZMD  
Bereichsleiter Montageprozesse
  - 1990 – 1996 ZMD  
Geschäftsbereichsleiter Montage, Sensoren und Mikrosysteme
  - 1996-2008 Microelectronic Packaging Dresden GmbH (MPD)  
Geschäftsführender Gesellschafter
- Spezialkenntnisse:**
- Feingeräte Konstruktion
  - Konstruktion, Technologien der Aufbau u. Verbindungstechnik für Halbleiter, Sensoren und Mikrosysteme
- Netzwerke:**
- Silicon Saxony: AG Mikrosystemtechnik
  - GMM: AG Aufbau und Verbindungstechnik
  - VDI: Beirat Werkstoffe
  - BVMW: Industrierat
  - IAVT: Ehrenmitglied Beirat